

## 天津中环半导体股份有限公司 关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

#### 1、担保事项的简要情况

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中环香港控股有限公司（以下简称“中环香港”）根据业务发展需要，拟向浦发银行等金融机构申请贷款，额度不超过7亿元人民币，期限不超过三年。上述贷款由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

以上担保额度以担保合同为准，随着融资债务逐年偿还，担保额度也随之逐年递减。

#### 2、本次披露的对外担保进展情况

本次《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，还需经公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

### 二、被担保人基本情况

中环香港为公司全资子公司，2012年11月获准在香港注册。

名称：中环香港控股有限公司

法人代表：张长旭

注册资本：50,100万元人民币

经营范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批未获审批的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。

截至2019年6月30日，中环香港总资产427,624.35万元，净资产106,003.44万元，2019年1-6月营业收入243,963.28万元，净利润3,913.44万元（未经审计）。

### 三、董事会意见

本次担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司对外担保管理制度的相关要求。本次子公司申请融资业务主要是用于公司发展的需要,是根据投资规划及资金需求情况确定的,有利于其长效、有序发展,公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至本公告日,除本次新增担保,公司及子公司累计对外担保额为 654,066.99 万元,实际累计对外担保额为 631,716.65 万元。本次担保后,公司及子公司累计对外担保额为人民币 724,066.99 万元(其中为控股子公司提供的担保额为 672,291.99 万元),占 2018 年末公司经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的归属于母公司净资产的比例为 54.34%。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

#### **五、备查文件**

第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2019 年 8 月 21 日